

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2726903

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОТОДИОДОВ  
СРЕДНЕВОЛНОВОГО ИК-ДИАПАЗОНА СПЕКТРА

Патентообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью  
"ИоффелЕД" (RU)*

Авторы: *Матвеев Борис Анатольевич (RU),  
Ременный Максим Анатольевич (RU)*

Заявка № 2019137271

Приоритет изобретения 19 ноября 2019 г.

Дата государственной регистрации в

Государственном реестре изобретений

Российской Федерации 16 июля 2020 г.

Срок действия исключительного права

на изобретение истекает 19 ноября 2039 г.

- Руководитель Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

Г.П. Ислеев





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

**(12) ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(52) СПК

H01L 31/1844 (2020.02)

(21)(22) Заявка: 2019137271, 19.11.2019

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:  
19.11.2019Дата регистрации:  
16.07.2020

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 19.11.2019

(45) Опубликовано: 16.07.2020 Бюл. № 20

Адрес для переписки:  
194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая,  
26, ФТИ

(72) Автор(ы):

Матвеев Борис Анатольевич (RU),  
Ременный Максим Анатольевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Общество с ограниченной ответственностью  
"ИоффеЛЕД" (RU)(56) Список документов, цитированных в отчете  
о поиске: RU 2647979 C1, 21.03.2018. RU  
2599905 C2, 20.10.2016. KR 1020090056934 A,  
03.06.2009. US H001856 H1, 05.09.2000. US  
8263966 B2, 11.09.2012. EA 201201245 A1,  
28.06.2013.

**(54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОТОДИОДОВ СРЕДНЕВОЛНОВОГО ИК-ДИАПАЗОНА СПЕКТРА**

**(57) Формула изобретения**

Способ изготовления фотодиодов средневолнового ИК-диапазона спектра, включающий выращивание на подложке из арсенида индия многослойной гетероструктуры, содержащей по крайней мере один слой твердого раствора  $InAs_{1-x-y}Sb_xP_y$  и разделенные p-n-переходом слои p- и n-типа проводимости, по крайней мере один из которых выполнен с высокой поглощающей способностью в рабочем диапазоне спектра, нанесение на поверхность гетероструктуры фоточувствительного материала, экспонирование через маску с системой темных и светлых полей, проявление, удаление, по крайней мере, части фоточувствительного материала с помощью органического растворителя, части эпитаксиальной структуры при формировании по крайней мере одной мезы, а также удаление упомянутой подложки или ее части при химическом травлении в водном растворе соляной кислоты, подготовку поверхности для формирования омических контактов, напыление на поверхность гетероструктуры металлических композиций заданной геометрии и монтаж фотодиодов на контактную плату с металлическими площадками для подсоединения проводников, отличающийся тем, что мезы формируют с высотой, не превышающей суммарную толщину эпитаксиальных слоев, расположенных между поверхностью гетероструктуры и близлежащим к подложке слоем твердого раствора  $InAs_{1-x-y}Sb_xP_y$ , и, по крайней мере, финишную стадию процесса удаления подложки начинают после завершения операции монтажа фотодиодов на упомянутую контактную плату и останавливают при полном

RU 2726903 C1

RU 2726903 C1

удалении подложки с поверхности гетероструктуры.

R U 2 7 2 6 9 0 3 C 1